



Potente tecnología AOI en 3D

Flexibilidad de uso como sistema de pista doble o individual

Monitor integrado para ahorrar espacio al máximo

Herramientas inteligentes para el control de procesos

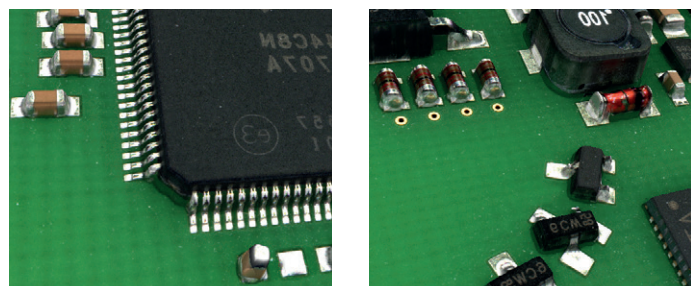
Plena integración en interfaces de última generación de Industry 4.0

Potente solución de inspección en 3D para líneas de doble pista

Con el S3088 DT todo son ventajas. Con una configuración optimizada para inspección con doble pista, se logra economía, velocidad y alto rendimiento en la línea de producción. Sus opciones de integración en red están diseñadas para obtener una comunicación completa con sistemas de gestión de la producción (MES), sistemas de control de líneas y otras máquinas. El S3088 DT brinda la herramienta perfecta a los fabricantes de productos electrónicos para ejecutar procesos completamente automatizados y conceptos de manejo exigentes con los que comprobar conjuntos electrónicos de manera rápida y segura.

Con el S3088 DT se detectan los puntos de soldadura y componentes de las PCB con rapidez y exactitud. La resolución ortogonal es de 10 μm /píxeles para inspeccionar con la máxima seguridad hasta componentes 03015. Una característica especial del sistema AOI en 3D es el tamaño de campo de imagen de 50 mm x 50 mm. La velocidad de inspección alcanza hasta 65 cm^2/s . El software de manejo ofrece múltiples herramientas auxiliares muy prácticas para controles de proceso regidos por principios de calidad. Los programas de inspección se crean rápidamente de manera intuitiva.

El sistema se adapta con flexibilidad a diferentes anchos de pista. Si es necesario, también puede utilizarse con una pista individual. El diseño del S3088 DT es ergonómico y compacto. El monitor integrado en la puerta de la carcasa permite maximizar el espacio útil, especialmente en fábricas con alta densidad de equipo en las líneas.



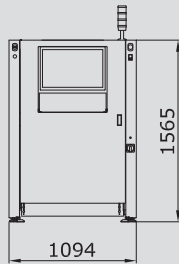
Con el software 360View de Viscom se proporciona imágenes en 3D para apreciar hasta los mínimos detalles y permite seleccionar cualquier perspectiva

AOI en 3D

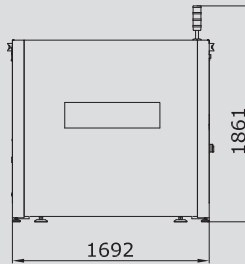
Datos técnicos



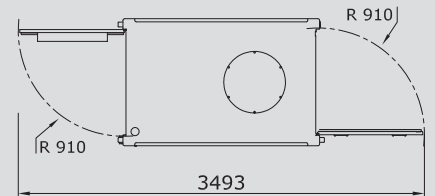
Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Expresado en mm

		S3088 DT
Alcance de la inspección	AOI en 3D	Puntos de soldadura, montaje de componentes, pasta de soldadura
Tecnología de sensores*	Tecnología de sensores 3D	
	Resolución en Z	0,5 µm
	Rango de medición en Z	Hasta 30 mm
	Cámaras de vista angular	
	Número de cámaras de megapíxeles	8
	Cámara ortogonal	
	Resolución	10 µm
	Tamaño de campo de imagen	50 mm x 50 mm
Software	Interfaz de usuario	EasyPro/vVision-ready de Viscom
	Control estadístico de procesos	SPC de Viscom, interfaz abierta (opcional)
	Estación de verificación	HARAN/vVerify de Viscom
	Diagnóstico remoto	SRC de Viscom (Software Remote Control) (opcional)
	Estación de programación	PST34 de Viscom (opcional)
Ordenador del sistema	Sistema operativo	Windows®
	Procesador	Intel® Core™ i7
Manipulación de PCBs	Concepto de transporte	Transporte de pista doble
	Tamaño de PCBs (longitud x anchura)	450 mm x 350 mm, ancho mínimo 70 mm
	Altura de transferencia	900 - 950 mm ± 20 mm
	Ajuste de ancho	Automático**
	Fijación de PCBs	Neumática
	Altura de paso superior (máx.)	50 mm
	Altura de paso inferior	40 mm**
Velocidad de inspección		Hasta 65 cm ² /s
Otros datos del sistema	Unidad de posicionamiento	Motores lineales síncronos
	Interfaces	SMEMA (otras interfaces bajo demanda)
	Conexión eléctrica	400 V (otras tensiones bajo demanda), 3P/N/PE, 8 A, aire comprimido máx. 10 bar (presión de trabajo 4 - 6 bar)
	Dimensiones del sistema	1094 mm x 1565 mm x 1692 mm (anchura x altura x profundidad)
	Peso	1400 kg

*Configuración estándar, otra tecnología de sensores bajo demanda.

** Diferentes ajustes de ancho o alturas de paso bajo demanda.